# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-166256

(43)Date of publication of application: 18.07.1991

(51)Int.CI.

B32B 15/08 H01B 3/34

H05K 3/46

(21)Application number: 01-305185

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

(22)Date of filing:

25.11.1989

(72)Inventor:

**MISAWA HIDETO** 

KOSEKI TAKAYOSHI

# (54) RESIN COMPOSITION AND LAMINATED BOARD THEREOF

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a flame retardant polyphenylene oxide-based resin composition, excellent in flame retardant, heat resistance and electrical characteristics and useful as laminated boards by blending a polyphenylene oxide with a solid flame retardant treated with a coupling surface treating agent.

CONSTITUTION: A flame retardant resin composition obtained by blending (A) a polyphenylene oxide with (B) a crosslinkable monomer and/or polymer [preferably triallyl (iso)cyanurate or a polymer thereof, etc.], (C) a solid flame retardant (preferably brominated diphenyl ether-based, brominated polycarbonate-based flame retardant, etc.) and a coupling surface treating agent (preferably a silane coupling agent having organic functional group, alkyl group or hydrolyzable groups), as necessary, (D) a flame retardant assistant (e.g. antimony oxide) and (E) a reaction initiator and containing the solid flame retardant treated with the coupling surface treating agent and useful as laminated boards.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-166256

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内築理番号

@公開 平成3年(1991)7月18日

C 08 L 71/12 B 32 B 15/08 H 01 B 3/34 H 05 K 3/46 LQM 6917-4 I Q 7148-4 F

9059-5G T 7039-5E

> 審査請求 未請求 請求項の数 7 (全10頁)

60発明の名称

樹脂組成物とその積層板

頤 平1-305185 の特

田田 顧 平1(1989)11月25日

(72)発 明 客 英

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会补内

四発 明 者

関 髙 小 好 大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

②出 人 顋

松下電工株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地

**HW** 理 弁理士 西澤 利夫

## 1. 発明の名称

樹脂組成物とその積 2. 特許請求の範囲

- ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物 (1) において、カップリング表面処理剤によって処理 した固形建裁剤を配合してなることを特徴とする 建歴化ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物。
- (2) ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物 において、固形難燃剤とともにカップリング表面 処理剤を混入し、固形難燃剤を表面処理して配合 してなる請求項(1)記載の難然化ポリフェニレ ンオキサイド系樹脂組成物。
- (3) カップリング表面処理剤が有機官能基、 アルキル基、または加水分解基を有するシランカ ップリング剤である請求項(1)記載の難燃化ポ リフェニレンオキサイド系樹脂組成物。
- ポリフェニレンオキサイド、架橋性のポ リマーおよび/またはモノマー、カップリング表

面処理剤によって処理した固形鍵盤剤、またその 難感剤と難感助剤、さらに必要に応じて反応開始 剤を配合してなる踏束項(1)記載の難燃化ポリ フェニレンオキサイド系樹脂組成物。

- **難燃剤が固形の臭素化ジフェニルエーテ** ル系、臭素化ポリカーポネート系、および/また は臭素化ビスフェノール系である請求項(1)記 観の難黙化ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成
- (6)難魅剤または難慇助剤が酸化アンチモン である請求項(1)記載の難燃化ポリフェニレン オキサイド系樹脂組成物。
- (7)請求項(1)記載の難燃化ポリフェニシ ンオキサイド系樹脂組成物からシートおよび/ま たはプリプレグを形成し、これを金属格と積層ー 一体化してなることを特徴とする難然化ポリフェ ニレンオキサイド系積層板。
- 3. 発明の詳細な説明
- (産業上の利用分野)

この発明は、難燃化ポリフェニレンオキサイド

系徴胎組成物とそれを用いた積層板に関するもの である。

さらに詳しくは、この発明は、電気機器、電子 機器等に用いられる配線板として有用な、建燃性 とともに耐熱性および電気絶縁性にも優れた鍵盤 化ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物とそれ を用いた金属張積層板に関するものである。

#### (従来の技術)

精密機器、電子計算機、通信概等に用いられる 記録板については、液算処理の高速化、高信頼化、 回路の高密度化、小形化の要求が高まっており、 これらの要求に対応するために配線板の多層化、 高格度微鏡化が急速に進んでいる。

従来、このような配数板には、それを構成する 樹脂として、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂や、 低誘電事樹脂としてのファ楽樹脂あるいはポリブ タジエン樹脂等が用いられてきており、またその 特性の改善も替力的に進められてきている。

たとえば、配線の高密度化が進むに伴い、多層 配線板に使用する観點としては、難燃性であるこ

与するものの、耐熱性および電気絶縁性の向上を 困難にするという欠点がある。

この欠点は、難然性の高い難燃剤は固形のものが多く、この固形難燃剤は、ポリフェニレンオキサイド系樹脂との密着性があまり良好でないということに帰因している。

この発明は、以上のような、従来の難然化ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物の欠点を解決するためになされたものであり、低誘電率で、しかも難然性とともに良好な耐熱性と電気絶縁性とを付与することのできる新しい難燃化樹脂組成物を提供することを目的としている。

#### (課題を解決するための手段)

この発明は、上記の課題を解決するものとして、ポリフェニレンオキサイド系数監組成物において、カップリング表面処理剤によって処理した固形異 燃剤を配合してなることを特徴とする異態化ポリフェニレンオキサイド系数監組成物を提供する。

また、この発明は、その好ましい組成として、 ポリフェニレンオキサイド、架積性のポリマーお とが必要不可欠の条件となってくる。しかし、従来の関節は一般に可燃型である。そこで、通常、配線板に使用する樹脂には、それを効率よく確実に建燃化するため、鍵燃剤を添加している。

しかしながら、樹胎自体を低誘電率のものとしても、雑燃剤を添加することにより樹脂誘電率が大きくなり、計測機器やコンピュータ関連機器で要求される信号処理の高速化に対応させることができない。

このような問題を解決するものとして、低誘電率で高速信号処理を安定して行うことができるとともに、鍵盤性に優れ、配線の多層高密度化を図ることのできる新しい積層板用の樹脂組成物としてポリフェニレンオキサイド系の鍵盤化樹脂組成物が提供されてきてもいる。

#### (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、このポリフェニレンオキサイド 系樹脂組成物は、その樹脂特性が優れたものであ り、プリント配線板用積層樹脂として期待される ものであるが、この難燃剤の添加は、難燃性を付

よび/またはモノマー、カップリング表面処理剤によって処理した固形の難燃剤または難燃剤と難 燃助剤、さらに必要に応じて反応開始剤を含有す ることを特徴とする難燃化ポリフェニレンオキサ イド系樹脂組成物を提供する。

さらにこの発明は、それを用いた積層板として、 上記録燃化ポリフェニレンオキサイド系制脂組成 物からシートおよび/またはブリプレグを形成し、 このシート/またはプリプレグを金属箔と積層一 体化してなることを特徴とする鍵燃化ポリフェニ レンオキサイド系樹脂積層板をも提供する。

この発明の難然化ポリフェニレンオキサイド系 樹脂組成物に用いるポリフェニレンオキサイドは、 ガラス転移点が比較的高く低誘電率、低誘電損失 の樹脂であり、さらに安値であることから近年注 目されているものである。ただ、これまではその 経燃性を改善することができなかったため、高密 度の配線板用の樹脂として実用に供するには至っ ていなかった。

しかしながら、この発明の発明者らは、ポリフ

特囿手3-166256(3)

(3)

ェニレンオキサイド系樹脂組成物に建燃剤または、 建燃剤と鍵盤助剤を添加することにより、その低 誘電性を維持させつつ難燃性を改善できることを 見出した。またさらに、ポリフェニレンオキサイ ド系樹脂組成物に難燃剤を含有させるに襲して、 架積性ポリマーおよび/またはモノマーを含有さ せると、樹脂の耐熱性、耐薬品性、加工性、す法 安定性も優れたものとなることを見出だしてもい る。

以上のような知見を踏まえて、この発明の難然 化ポリフェニレンオキサイド系数胎組成物におい ては、好適には、ポリフェニレンオキサイドに、 架橋性ポリマーおよび/または架積性モノマーと、 カップリング表面処理剤によって処理した固彩の 難燃剤または難燃剤と難燃助剤とを含有させて使 用する。

この発明で使用するポリフェニレンオキサイド は、たとえば、

つぎの一般式(1)

チレンジアミン、ブチルジメチルアミンおよび臭化水素を含む。また、メタノールは、これを基準にして2~15型量%の水を反応混合系に加え、メタノールと水の合計が5~25重量%の重合溶媒となるようにして用いる。

架橋性ポリマーとしては、たとえば、1,2一ポリプタジエン、1,4ーポリプタジエン、スチレンプタジエンコポリマ、変性1,2ーポリブタジエン(マレイン変性、アクリル変性、エポキシ変性)、ゴム類、ポリトリアリルイソシアヌレート、ポリトリアリルシアヌレートなどがあげられ、それぞれ、単独でまたは2種以上併せて用いることができる。これらのポリマーの状態は、エラストマーでもラバーでもよい。

ただし、この発明の積層板を後述するキャスティング法により成形したフィルムを用いて製造する場合には、そのフィルムの成膜性を良くするという点から、比較的高分子量のポリスチレンを用いることが好ましい。

なお、ポリトリアリルイソシアヌレートまたは

[Rは、水素または炭素数1~3の炭化水素基を表し、各Rは、同じであってもよく、異なってもよい。]

で表されるものであり、その一例としては、ポリ (2.6-ジメチル~1.4-フェニレンオキサ イド)を挙げることができる。

その分子量は特に限定するものではないが、たとえば、単量平均分子量(Mw)が50.000、分子量分布Mw/Mn=4.2(Mnは数平均分子量)であることが好ましい。

このようなポリフェニレンオキサイドは、たとえば上記ポリ(2,6 - ジメチルー1 ・4 - フェニレンオキサイド)については、2,6 - キシンノールを触媒の存在下で、酸素を含む気体およびメタノールと酸化カップリング反応させることにより得ることができる。ここで、触媒としては、銅(I)化合物、N、N・-ジーtertーブチルエ

ポリアリルシアヌレートのポリマーは、溶液重合 または塊状重合の方法によって合成することがで きる。

この場合の溶液重合は、塊状重合法に比べて反 必な種がであり、分子量調整が容易なものである。 トリアリルイソシアメレートモノマーまたはトリ アリルシアメレートモノマーを溶媒に溶解し、ラ ジカル開始剤を混入して適当な分子量になるまで 提择しながら反応させ、必要に応じて加熱する方 法によって実施することができる。その際に、 湿 造器を用いて、また酸素が存在しない雰囲気下で、 反応させるのが好ましい。

反応雰囲気としては、たとえば窒素流通雰囲気とすることができる。また、海媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、メタノール、エタノール、アセトン、メチルエチルケトン、ヘプタン、四塩化促素、ジクロロメタン、トリクロロエチレンなどを用いることができる。

ラジカル開始剤としては、従来公知のものをは じめとして適宜なものを用いることができ、たと えば、ベンソイルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2.5-ジ(ベンソイルパーオキシ)へキサン、t-ブチルパーオキシベンゾエート、ジクミルパーオキシドなどを例示することができる。

たとえば、トリアリルイソシアヌレートアレポ リマーは次のようにして合成することができる。 (例 1)

トリアリルイソシアヌレートモノマー280 gにベンプイルパーオキシド11g、ベンゼン1087gを加え、批拌版、湿流冷却器付反応器を用いて、窒素雰囲気下で沸騰させながら6時間反応させる。ベンゼンを減圧回収した後にメタノールを加え、重合物を回収し、減圧乾燥する。139 gの重合物を得る。数平均分子量は約10,000である。(例2)

トリアリルイソシアヌレート225 g にジクミル パーオキシド10g、トルエン527 g を加え、例 1と同様にしてプレポリマーを得る。数平均分子 量は約4,000 である。

たとえば以上のようにして合成することのでき

このトリアリルシアヌレートとトリアリルイソ シアヌレートとは、化学構造的には異性体の関係 にあり、ほぼ同様の成膜性、相密性、溶解性、反 応性などを有するので、いずれか一方ずつまたは 両方ともに同様に使用することができる。

以上のような架賃性ポリマーおよび架賃性モノマーは、いずれか一方のみを用いるようにしてもよいし、併用するようにしてもよいが、併用するほうがより特性改善に効果がある。

この発明に使用する難燃剤としては、通常、難燃剤を軽燃助剤と共に添加した後のポリフェニレンオキサイド系制脂組成物の比誘電率を4.6 以下にでき、かつその難燃性をじし94難燃性試験法に基づく特性としてV-1あるいはV-0にできるものを使用するのが好ましい。

たとえば、つぎの式 ( 2 ) を有する臭業化ジフェニルエーテル系

るトリアリルイソシアヌレートまたはトリアリルシアヌレートのアレボリマーの数平均分子量は 10.000以下とするのが好ましい。

また、架賃性モノマーとしては、たとえば、① エステルアクリレート類、エポキシアクリレート 類、ウレタンアクリレート類、エーテルアクリレ ート類、メラミンアクリレート類、アルキドアク リレート類、シリコンアクリレート類などのアク リレート類、②トリアリルシアヌレート、トリア リルイソシアヌレート、エチレングリコールジメ タクリレート、ジビニルベンゼン、ジアリルフタ レートなどの多官能モノマー、③ビニルトルエン、 エチルピニルベンゼン、スチレン、バラメチルス チレンなどの単官能モノマー、④多官能エポキシ 類などが挙げられ、それぞれ、単独であるいは2 種以上併せて用いることができる。このうち、ト リアリルシアヌレートおよび/またはトリアリル イソシアヌレートが、ポリフェニレンオキサイド と相寄性が良く、成膜性、架構性、耐熱性および 誘電特性を向上させるので好ましい。

(式中、Rは水素、芳香族基または脂肪族基を表す。)、あるいは次の式(3)を有する臭素化ポリカーボネイト系、

$$R = 0 \longrightarrow \begin{cases} c_{13} \\ c_{13} \\ c_{13} \\ c_{13} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} c_{13} \\ c_{13} \\ c_{13} \end{cases}$$

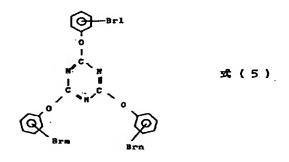
(式中、Rは水素、芳香族基または脂肪族基を表す。)

または、次の式(4)を有する臭素化ビスフェ ノール系、

(式巾、 R <sup>1</sup> および R <sup>2</sup> は、各々、水素、芳香族 基または脂肪族基、もしくは次の式 < i > ~ < vi > のいずれかで示される基を表わす。

特開平3-166256 (5)

さらには、次の式(5)を有する臭業化シアヌル 酸系



とをカップリング表面処理所によって処理して樹 脂組成物に配合することを特徴としている。

この際のカップリング表面処理剤としては、ビニル基、エポキシ基、アミノ基、アクリル基、メルカプト基等の有機官能基やアルキル基、あるいは加水分解可能基、たとえばメトキシ基、エトキシ基を有するカップリング剤、特にシラン系カップリング剤が好ましいものとして用いられる。エポキシシラン、アミノシラン、アクリロキシシラン、アルコキシシラン等がその例として示される。

これらのカップリング表面処理剤は、あらかじめ固形の鍵盤剤、さらには鍵盤助剤を処理した状態で樹脂組成物に配合使用するか、固形鍵盤剤と別々に樹脂組成物に混入し、同時に処理するように配合使用するようにしてもよい。

以上のような架積性ポリマーおよび/またはモノマー、カップリング表面処理剤によって処理した固形難燃剤または難燃剤と難燃助剤をポリフェニレンオキサイドに配合するに際しては、さらに開始剤を用いることができる。

(つ) を使用することができる。

これらの難燃剤は単独で使用してもよく、また 併用しても良い。

この発明においては、必要に応じてこのような 難燃剤と共に難燃助剤を併用し、これにより、難 燃化に相乗効果をもたらすこともできる。

難燃助剤としては、例えば、酸化アンチモン (三酸化アンチモン、五酸化アンチモン)、酸化 ジルコニウム等を用いることができる。

これらの建燃助剤は単独で使用してもよく、また 併用してもよい、これらの建燃助剤は、単独また は併用により 建燃剤として使用できる場合もある。

なお、酸化アンチモンを使用する場合には、有 機密媒に分散させて用いるのが取扱を容易にする うえで好ましい。

この発明においては、これらの残燃剤、すなわち、固形難燃剤とポリフェニレンオキシド系 樹脂との密着性を向上させ、樹脂成形品、すなわち積層板の耐熱性および電気絶縁性を良好なものとするため、関形の難燃剤もしくは難燃剤と鍵燃助剤

関始剤としては、ポリフェニレンオキサイド樹脂組成物を紫外線硬化型がまたは熱硬化型にするかにより以下の2通りのものを選ぶことができるが、これらに限定されることはない。

集外級硬化型の光朗始新(すなわち、紫外線照射によりラジカルを発生するもの)としては、ベンブイン、ベンジル、アリルジアゾニウムフロロほう酸塩、ベンジルメチルケタール、2,2一ジエトキシアセトフェノン、ベンソイルイソブチルエーテル、pーtertーブチルトリクロロアセトフェノン、ベンジル(oーエトキシカルボニル)、αーモノオキシム、ピアセチル、アセトフェノン、ベンブフェノン、ミヒラーケトン、テトラメチルチウラムスルフィド、アゾビスイソブチロニトリルなどが使用できる。

また熱硬化型の関始剤(すなわち、熱によりラジカルを発生するもの)としては、ジクミルパーオキサイド、tert-ブチルクミルパーオキサイド、ペンゾイルパーオキサイド、ジーtert-ブチルパーオキサイド、2.5-ジメチル-2.5-ジー

(tert-ブチルパーオキシ) ヘキシン-3、2, 5-ジメチルー2、5-ジー(tertーブチルパー オキシ)へキサン、α、α´ービス(tertープチ ルパーオキシーm-イソアロピル) ベンゼン [ 1 . 4 (または1, 3) - ピス (lert-ブチルパーオ キシイソプロピル)ベンゼンともいう〕などの過 酸化物、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニル エドン、2ーヒドロキシー2ーメチルー1ーフェ ニループロパン-1-オン、1-(4-イソプロ ヒルフェニル) -2-ヒドロキシ-2-メチルプ ロパン-1-オン、2-クロロチオキサントン、 メチルベンゾイルフォーメート、4、4-ビスジ メチルアミノベンゾフェノン(ミヒラーケトン)、 ペンソインメチルエーテル、メチルーローペイゾ イルペンゾエート、α-アシロキシムエステル、 日本油脂酸のピスクミルなどを使用できる。

これらの開始剤は、それぞれ、単独でまたは2 種以上併せて用いてもよい。

また、紫外線による開始剤と熱による開始剤と を併用してもかまわない。

さらに種々の無機充填剤を含有させることによって、その誘電事等の特性を変化させてもよい。このような無機充填剤としては、たとえば、二酸化チタン系セラミック、チタン酸鉛系セラミック、チタン酸コンウム系セラミック、チタン酸カルシウム系セラミック、ジルコン酸鉛系セラミックなどを単独よたは複数併せて使用することができる。

 以上のポリフェニレンオキサイド、架橋性のポリマーおよび/またはモノマー、表面処理した鍵盤剤または建燃剤と難燃助剤、さらには反応開始剤の配合剤合は、通常、好適にはポリフェニレンオキサイド5~95重量%、架橋性ポリマー/とノマー1~95重量%、建燃剤1~90重量%、建燃助剤1~50重量%とする。カップリング表面処理剤は、0.5~15重量%程度の使用量とするのが好速である。また、このような配合に加えて含有させる反応開始剤の配合剤合は、0~10重量%とするのが好ましい。

程燃剤の配合創合は、その経燃剤の難燃化能、 程燃剤自体の比誘電率及びその程燃剤の添加後の 樹脂組成物に必要とされる比誘電率の大きさや樹脂特性に応じて定める。

なお、この発明の難燃化ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物は以上のように、ポリフェニレンオキサイド、架橋性のポリマーおよび/またはモノマー、カップリング表面処理剤によって処理した難燃剤、難燃助剤、反応開始剤を含有するが、

などを使用でき、特にトリクロロエチレンが好ま しい。これらはそれぞれ単独でまた2つ以上混合 して用いることができる。

この発明の程態化ポリフェニレンオキサイド系 製脂積層板は、個形程盤剤をカップリング表面処理してなる程盤化ポリフェニレンオキサイド系樹脂 組成物からシートを形成し、またはこれを基材に含浸させてアリアレグを形成し、さらに必要によりそれらシート、プリアレグからコア村等を製造し、次いで、常法に従って他の基材、フィルム、プリアレグ、金属箔等とともに積層一体化することにより製造することができる。多層成形も同様とする。

雅感化ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物 からシートを形成するに際しては、例えば、キャ スティング法を用いることができる。

キャスティング法は、溶剤に混合している樹脂 を流延または塗布等により薄層にした後その溶剤 を除去することにより硬化物とする方法である。 キャスティング法によればコストがかかるカレン

# 特開手3-166256 (7)

ダー法によらず、しかも低温で硬化物を得ることができる。このキャスティング法をより具体的に 設明すると、溶剤に混合した状態の難燃化ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物を鏡面処理した た鉄板またはキャスティング用キャリアーフィルムなどの上に、たとえば、5~700 (籽ましくは、5~500)μmの厚みに流延(または、塗布)し、十分に乾燥させて溶剤を除去することによりシートを得るというものである。

キャスティング用キャリアーフィルムとしては、 特に限定されるわけではないが、ポリエチレンテ レフタレート(以下、「PET」と略す)フィル ム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィ ルム、ポリエステルフィルム、ポリイミドフィル ムなど上記密剤に不溶のものが好ましく、かつ、 群型処理したものが好ましい。

乾燥は、風乾または熱風乾燥等により行う。その際の温度範囲は、上限を溶剤の沸点よりも低い、か、または、キャスティング用キャリアーフィルムの耐熱温度よりも低くすること(キャスティン

建燃化ポリフェニレンオキサイド系制船組成物の合設量は、特に限定しないが、30~80重量%とするのが好ましい。基材は、ガラスクロス、アラミドクロス、ポリエステルクロス、ナイロンクロス等樹脂含浸可能なクロス状物、それらの材質からなるマット状物および/または不識布などの繊維状物、クラフト紙、リンター紙などの紙などを用いることができ、これらに限定されない。

この発明の金属張積層板を形成する場合に用いる回路形成用の金属箔としては、通常配線板に用いるものを広く使用することができる。たとえば、網箔、アルミニウム箔等の金属箔を用いることができる。この場合、金属箔は、接着表面が平滑でかつ導電性の良いものが、アリント配線板特性を良好にする上で好ましい。

このような金属街は、サブトラクティブ法等により所望の導体を形成することができる。また、 悪着やアディティブ法(フルアディティブ法、セ ミアディティブ法)などにより所望の導体(回路、 電極など)として形成してもよい。

<sup>(7)</sup> グ用キャリアーフィルム上で乾燥を行う場合)が 好ましい。

また下限は乾燥時間や処理性などによって決めるものとし、たとえば、トリクロロエチレンを溶剤とし、PETフィルムをキャスティング用キャリアーフィルムとして用いる場合には、室温から80℃までの範囲にするのが好ましい。なお、この範囲内で温度を高くすれば乾燥時間の短縮が可能となる。

固形難燃剤を表面処理してなるこの発明の難燃 化ポリフェニレンオキサイド系樹脂機組成物を基 材に含浸させてプリプレグを製造するに際しては、 一般に以下のような方法をとることができる。

すなわち、固形難燃剤表面処理してなる難燃化ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物の溶剤分散液中に基材を浸漬 (ディッピング) するなどして、基材に難燃化ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物を含浸させ付着させる。そして乾燥などにより溶剤を除去するか、あるいは半硬化させてBステージにする。この場合の難燃剤表面処理・

難燃化ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物から製造したコア村、シート、プリプレグを用いて積層板を製造する方法としては、たとえば以下のような方法を用いることができる。

ここで、シート、プリアレグ、コア材を併用する場合の組み合わせであるが、特に限定しないが、

(8)

上下対称の組み合わせにすることが成形後、二次 加工 (エッチング等)後のそり防止という点から 好ましい。また、金属箔との接着界面にはシート がくるように組み合わせたほうが接着力を向上さ せることができるので好ましい。

加熱圧結の数の温度は、金属箔とフィルムあるいはプリアレグの組合せ等によるが、たとえば、金属箔とシートの接着は、シートの熱融着性を利用できるので、積層圧結温度はシートのガラス転移点以上で、だいたい160~300 でぐらいの範囲にするのが軒ましい。

また、この発明の難燃射表面処理・難燃化ポリフェニレンオキサイド系例監組成物を乾燥器の中に入れて加熱するなどにより架橋する場合、架橋反応は、使用する開始剤の反応温度等に依存するので、加熱温度及び加熱時間は開始剤の種類に応じて選ぶ。たとえば、温度150~300 で、時間10~60分間程度である。

圧縮は、シート同士、シートとプリプレグ、ア リアレグ同士、金属箱とシート、金属箱とアリア

次に実施例を示し、この発明の難燃化ポリフェニレンオキサイド系制監组成物及びそれを用いたこの発明の金属装積層板についてさらに説明する。 (実施例)

#### 実施例1

#### 減圧装置付反応器に

- ポリフェニレンオキサイド 390 g (GE PPO)
- スチレンブタジエンコポリマー 350 g (旭化成工業例; ソルプレンT406)
- トリアリルイソシアヌレート 40 g(日本化成樹: TAIC)
- ジクミルパーオキサイド 20g(日本油脂:パークミルD)
- トリクロロエチレン 1000g (東亞合成化学:トリクレン)

の混合物とともに、鍵盤剤としてのペンタブロモジフェニルエーテル(第一工業製薬、SR-250)を、表面処理剤シランカップリング化合物(東芝シリコーン、TSL 8173)と一緒に添加

レグなどの接合、積層板の厚み調整のために行う ので圧縮条件は必要に応じて選択する。

たとえば、圧力30~80kg/di程度とすることができる。

以上のような加熱圧離は、あらかじめ食配フィルムおよび/またはプリアレグを所定枚加熱積層成形しておき、これの片面あるいは両面に金属箔を重ね合わせて、再び加熱圧離するようにしても ない。

#### (作用)

この発明の難燃化ポリフェニレンオキサイド系 樹脂組成物は、固形鍵燃剤をシランカップリング 剤等によってカップリング表面処理することによ り、鍵燃剤と樹脂と密着性を向上させ、鍵燃性と ともにポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物の 優れた耐熱性および電気絶縁性を発揮する。

従って、この発明の建燃化ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物を使用した積層板は、高精度加工が容易であり、高速信号処理に適し、高密度多層化をも実現できる。

混合し、均一となるまで充分に撹拌して、脱泡後に默燃化ポリフェニレンオキサイド系機路組成物 を得る。

この樹脂組成物ワニスを樹脂量が50%となるようにガラスクロス基材(日東紡:WE 116 E)に含浸し、80℃で30分間乾燥してプリアレグシートを製造する。

このシート4枚を上下の網路と重ね合わせ、 180 ℃、30kg/cdの条件で90分間圧篩して積 周一体化し、両面網張積層板を得る。この積層板 について、難燃性、耐熱性、および電気絶縁性に ついて評価した。

その結果を表1に示した。

後述の比較例との対比からも明らかなように、 固形錐燃剤をカップリング表面処理してワニスに 配合するこの発明の樹脂組成物およびこれを用い た視層板の場合には、難燃性とともに、耐熱性、 電気絶縁性にも優れていることがわかる。

実施例2~5

難燃化ポリフェニレンオキサイド系観胎組成物

(9

の配合を表1のようにし、同様にして4種類の樹脂組成物を製造した。また、その樹脂組成物を用いて同様に両面銅張積層板を作製した。

得られた積層板の物性を、難燃性、耐熱性、および電気絶縁性について評価した。その結果を要 1 に示した。いずれの特性も優れていた。

#### 比較例1~2

ポリフェニレンオキサイド系樹脂組成物に鍵燃 剤を配合しない場合と、表面処理しない鍵燃剤を 配合した場合とについて、樹脂組成物を製造し、 このワニスを用いて実施例1と同様にして種間板 を得た。その配合は表1に示した。また、その樹脂組成物を用いた積層板について、その物性を 定した。鍵燃性、電気絶縁性ともに劣り、プリント配線板特性としては満足できるものではなかった。

爱 1

	. 実施例					比較例	
试 联No.	1	2	3	4	5	1	2
维 燃 剤	SR-250	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TSL 8173 であらかじめ 処理した SR-250	SR-250	SR-250 (50g) Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (50g)	0	SR-250
カップリング	TSL	TSL		TSL	TSL .		
表面処理剤・	8173	8173		8331	8331	0	0
建燃性 a)	94V-0	94V-1	94V-0	94V-0	94V-0	燃烧	94V-0
耐熱性 b)	120<	120<	<b>÷</b> 60	<b>÷</b> 60	÷60	120<	129<
重氮胞释性	1 O 10	1 0 <sup>10</sup>	1 0 <sup>10</sup>	1 0 <sup>10</sup>	1 0 10	10 <sup>9</sup>	108
(Ω)			1				

### (注) SR-250(第一工業製薬)

TSL8173 (東芝シリコーン)メトキシシランカップリング剤 TSL8331 (東芝シリコーン)アミノシランカップリング剤

- a) 難燃性の評価 UL法に従う。
- b)耐熱性の評価 半田 (260 ℃) に絶えうる時間 (秒)。

(発明の効果)

この発明により、以上詳しく説明した通り、鍵 燃剤と樹脂との密着性は向上し、建燃性とともに、 耐熱性および電気絶縁性の良好なポリフェニレン オキサイド系樹脂含没、もしくは樹脂シートを用 いた高性能な積層板を実現することが可能となる。

化理人 弁理士 西 澤 利 夫